

杭州士兰微电子股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

2020 年 1 月 1 日至本公告披露日，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计收到政府补助资金 1891.836 万元（未经审计），具体明细如下：

序号	获得补助单位	补助项目	补助金额 (万元)	资金到账时间	补助依据	补助类型
1	杭州士兰微电子股份有限公司	高性能手机快速充电芯片解决方案研发及产业化	271.24	2020 年 1 月 20 日、 2020 年 3 月 10 日	杭经信电子[2019]113 号《关于公布 2019 年（第二批）杭州市集成电路产业发展专项项目名单的通知》； 区经信[2020]3 号《关于下达 2019 年杭州市工信产业发展专项项目区配套资金的通知》	与收益相关
2	杭州士兰微电子股份有限公司	低功耗高性能音频处理系列芯片的研发及产业化	143.4	2020 年 1 月 20 日、 2020 年 3 月 10 日	杭经信电子[2019]113 号《关于公布 2019 年（第二批）杭州市集成电路产业发展专项项目名单的通知》； 区经信[2020]3 号《关于下达 2019 年杭州市工信产业发展专项项目区配套资金的通知》	与收益相关
3	杭州士兰集昕微电子有限公司	工业互联网智能传感器、芯片研发及应用-MEMS 硅麦克风传感器的研发及其产业化	120.00	2020 年 3 月 2 日	杭科技[2019]189 号《关于提前下达 2020 年省科技发展专项资金的通知》	与收益相关
4	杭州士兰集昕微电子有限公司	2018 年 8 英寸扩产技改项目	170.58	2020 年 4 月 2 日	杭经信电子[2019]113 号《关于公布 2019 年（第二批）杭州市集成电路发展专项项目名单的通知》	与资产相关
5	杭州士兰明芯科技有限公司	新增年产 20 万片项目 LED 芯片产	121.49	2020 年 4 月 2 日	杭经信电子[2019]113 号《关于公布 2019 年（第二	与资产相关

		能提升技术改造			批) 杭州市集成电路发展专项项目名单的通知》	
6	成都士兰半导体制造有限公司	2019 年省工业发展资金补助	133	2020 年 3 月 18 日	《关于 2019 年四川省省级工业发展资金评审通过项目的公示》及名单	与收益相关
7	成都集佳科技有限公司	企业稳岗补贴	438.768	2020 年 1 月 22 日	成人社发[2019]29 号《成都市人力资源和社会保障局等十部门关于做好暂时困难企业稳岗补贴审定工作的补充通知》	与收益相关
8	其他小额补助	其他小额补助项目	493.358			与资产相关/ 与收益相关
合计	-	-	1891.836	-	-	-

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定认为，上述政府补助资金同时包含与资产相关部分和与收益相关部分，其中计入当期损益的金额约为 1515.316 万元。最终的会计处理以及对公司 2020 年度利润产生的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日